

# 部品内蔵型三次元実装技術標準化G

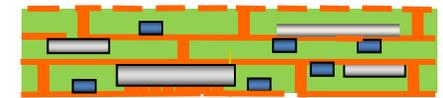
主査代行：春日壽夫（基準認証イノベーション技術研究組合）  
メンバー：7社＋5組織、17名

## ◆ 目的

部品内蔵型三次元実装技術（部品内蔵実装技術）に関わる標準化の審議を行う。

## ◆ 活動の概要

- IEC TC91 WG6 (Device embedding assembly technology) の国内対応検討組織としてIEC TC91WG6国際会議における審議対応を行う。部品内蔵基板、部品内蔵型三次元電子モジュールおよび関連技術を含む）
- IEC 62878シリーズの規格作成及び改定を進める。
- 部品内蔵型三次元実装技術（部品内蔵実装技術）に関わる三次元実装技術の技術分類、用語等の調査を行い、標準化に関わる課題の抽出を行う。
- 内外関連団体との連携（JEITA内委員会、JIEP、JIC：Jisso international Council他）



（三次元電子モジュールの例）

## ◆ 担当するIEC規格体系と文書

### 規格体系

**IEC62878: Device embedding assembly technology**

**IEC62878-Part 1: Generic specification**

**IEC62878-Part 2: Guide line**

**IEC62878-Part 3: Sectional Requirements (TBD)**

### IEC文書 (IS:規格、IS:技術仕様書、TR:技術文書)

<b>IEC 62878-1(Part 1)</b>	<b>Generic specification [IS] &lt;2019発刊&gt;</b>
IEC 62878-1-1	Generic specification - Test methods [IS] <b>日本提案</b>
<b>IEC62878-2(Part 2)</b>	<b>Guide line</b>
IEC/TS 62878-2-1	General description of technology [TS] <b>日本提案</b>
IEC/TR 62878-2-2	Electrical testing [TR]
IEC/TS 62878-2-3	Design Guide [TS] <b>日本提案</b>

## ◆ 担当するIEC文書

IEC/TS 62878-2-4	Test element groups(TEG) [TS] <b>日本提案</b>
IEC 62878-2-5	Implementation of a 3D data format for device embedded substrate ( <u>FUJIKO format</u> ) [IS] <2019発行>* <b>日本提案</b> (部品内蔵基板用三次元データフォーマット:FUJIKO)
IEC 62878-2-600 series	Requirements of stacked electronic module - Guideline for stacked electronic module
IEC 62878-2-601	Generic Spec [TBD]
IEC 62878-2-602*	Evaluation method of inter-module electrical connectivity [審議中]* <b>日本提案</b> (積層モジュール間の電氣的接続の評価方法)
IEC 62878-2-603*	Evaluation method of intra-module electrical connectivity [審議中]* <b>日本提案</b> (モジュール内部を含むモジュール全体の電氣的接続の評価方法)

## ◆ 担当するIEC文書

IEC/TR 62878-2-7	Accelerated stress testing of passive embedded circuit boards [TR] <2019発行>
IEC/TR 62878-2-8*	Warpage Control of Active Device Embedded Substrate [審議中]
IEC/TR 62878-2-9*	Concept of JISSO level in the electronic industries [審議中]* 日本提案

**IEC62878-3(Part 3) Sectional Requirements (TBD)**